

Microbond Soft Solder Flux

Prod.Nr. 94.6681.5070

**"No clean" - Flußmittel auf Kolophoniumbasis,
schwach aktiviert, halogenfrei, dispenserbar**

Das Flußmittel ist schwach aktiviert und halogenfrei. Es ist sowohl für die SM- als auch für die Hybridtechnik geeignet. Die Flußmittelzusammensetzung entspricht dem Typ 1.1.3.C nach DIN/EN 29454 (Kolophoniumharz, ohne Halogene aktiviert). In seinem Korrosionsverhalten entspricht das Flußmittel dem früher gültigen F-SW 32 Flußmitteltyp nach DIN 8511, Teil 2. Hervorragende Eigenschaften der Fluxpaste sind

gute Benetzung sowie exzellente Reinigungsmöglichkeiten in zeitgemäßen Reinigungsmedien. Die geringen Flußmittelrückstände können aber auch auf der Schaltung verbleiben, da die Anforderungen an den Oberflächenisolationswiderstand (SIR) entsprechend DIN 32513 erfüllt werden. Die Viskosität der Paste ist für den Dispensereinsatz eingestellt, und sie verfügt daher über sehr gute Dosiereigenschaften.

1. Pasteneigenschaften

1.1 Flußmitteltyp

kolophoniumhaltig, ohne Halogene aktiviert, pastös

1.2 Benetzung auf Cu, Ag sowie anderen in der SM-Technik üblichen Oberflächen

sehr gut

1.3 Korrosionsverhalten nach DIN 32513, Pkt. 4,5

Klasse 2

1.4 Oberflächenwiderstand und elektr. Korrosionswirkung nach DIN 32513, 4.6

erfüllt

1.5 pH-Wert

4.7 - 4.9

2. Lagerfähigkeit

Wir garantieren eine Lagerfähigkeit von 12 Monaten bei Lagerung in ungeöffneten Gebinden bei $T = 15 - 25^{\circ}\text{C}$.

3. Lieferform

*Versiegelte Polyethylen-Kartuschen zu 5 g, 10g und 30 g;
Sonderabfüllungen auf Anfrage*

4. Verarbeitung

- Die Flußmittelpaste neigt durch die besonders ausgeprägte Thixotropie nicht zum Absetzen und Entmischen in der Kartusche. Die Lagertemperatur sollte max. 25°C nicht überschreiten. Es ist eine möglichst gleichmäßige Lagertemperatur einzuhalten. In ungeöffneten Gebinden ist die Paste 12 Monate lagerfähig.*
- Die Viskosität ist für die Verarbeitung mit den diversen Dosiersystemen gebrauchsfähig eingestellt. Selbst bei minimalem Düsendurchmesser von 0,25 mm ist ein einwandfrei reproduzierbares Dosierergebnis zu erzielen.*
- Eine Vortrocknung der Fluxpaste ist für übliche Reflowprozesse (IR-, Konvektionsdurchlauföfen, Dampfphase etc.) nicht notwendig. Beim Reparaturlöten mit Heißluft sollte die Paste gegebenenfalls bei max. 150°C angetrocknet werden, um ein explosionsartiges Verdampfen der Lösemittel beim danach folgenden Lötprozeß zu vermeiden.*
- Eine Lagerung der befluxten Lötstellen bis 72 Std. bei Raumtemperatur und rel. Luftfeuchte bis 75 % beeinflusst die Qualität der Lötung nicht.*
- Eine Reinigung der Fluxrückstände ist möglich mit CFK-Ersatzstoffen wie z. B. Terpenen und unter Zuhilfenahme von Ultraschall auch mit Isopropylalkohol.*
- Bitte beachten Sie die Arbeitsschutzbestimmungen für die jeweiligen Reinigungsmittel.*